



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会社名 内外テック株式会社
代表者名 代表取締役社長 権田 浩一
(JASDAQ・コード3374)
問合せ先 取締役 管理本部長 佐々木 政彦
電 話 03-5433-1123 (代表)

業績予想値と決算値との差異に関するお知らせ

平成27年5月13日に公表いたしました平成28年3月期(平成27年4月1日～平成28年3月31日)の通期業績予想値(連結・個別)と、本日公表の平成28年3月期決算の実績値に差異が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 業績予想値と決算値との差異

(1) 平成28年3月期通期連結業績予想値と実績値との差異

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

	売 上 高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する当期 純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想 (A) (平成27年5月13日発表)	百万円 18,546	百万円 342	百万円 316	百万円 286	円 銭 58.84
今回実績 (B)	19,531	614	584	444	91.44
増減額 (B-A)	985	272	268	158	—
増減率 (%)	5.3	79.5	84.8	55.2	—
(ご参考) 前期実績 (平成27年3月期)	17,727	468	423	372	76.67

(2) 平成28年3月期通期個別業績予想値と実績値との差異

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

	売 上 高	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想 (A) (平成27年5月13日発表)	百万円 17,204	百万円 233	百万円 206	円 銭 42.54
今回実績 (B)	18,172	485	350	72.04
増減額 (B-A)	968	252	144	—
増減率 (%)	5.6	108.2	69.9	—
(ご参考) 前期実績 (平成27年3月期)	16,431	359	292	60.08

2. 差異の理由（連結・個別）

当社グループの主要取引先企業の多くが属する半導体業界や半導体製造装置業界では、スマートフォン等の多機能携帯端末用半導体の増産投資、先端技術への積極的な設備投資、データセンター向け半導体需要拡大に伴う設備投資、イメージセンサー事業への設備投資等により、半導体製造装置メーカーの受注は概ね堅調に推移しました。

また、FPD（フラットパネルディスプレイ）製造装置業界では、モバイル用途の中小型パネル向けの設備投資に減速がみられたものの、中国を中心に大型液晶パネル向け設備投資が拡大したことから、FPD製造装置メーカーの受注は概ね堅調に推移しました。

この結果、主要取引先である半導体製造装置メーカーからの受注が通期にわたって堅調に推移したことから、「売上高」の実績値は予想値を上回りました。

また、損益面では、営業強化に伴う販売費及び一般管理費の増加はあったものの、売上高増加による利益の増加や原価改善が進んだこと等により、「営業利益」、「経常利益」および「親会社株主に帰属する当期純利益」（個別では「当期純利益」）の実績値は予想値を大きく上回りました。

以 上